

經濟部產業發展署 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

版本：P-V6x-DTRI

經濟部產業發展署（以下簡稱本署）為遵守個人資料保護法令及本署個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

一、蒐集目的及類別

本署因辦理或執行**半導體國際連結創新賦能計畫**業務、活動、計畫、提供服務及供本署用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本署組織規章定業務、寄送本署或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：**姓名、職稱、出生年、工作年資、教育程度、單位名稱、電話號碼、電子郵件地址**。

※您日後如不願再收到本署所寄送之行銷訊息，可於收到前述訊息時，直接點選訊息內拒絕接受之連結。

二、個人資料利用之期間、地區、對象及方式

- (一) 期間：蒐集至 114 年 12 月 31 日
- (二) 地區：中華民國主權範圍內
- (三) 對象：本署自行使用
- (四) 方式：以書面/或電子等形式處理、利用

三、當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或以電子郵件聯繫(iei@iii.org.tw)向本署行使下列權利：

- (一) 查詢或請求閱覽。
- (二) 請求製給複製本。
- (三) 請求補充或更正。
- (四) 請求停止蒐集、處理及利用
- (五) 請求刪除您的個人資料。

四、不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本署將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

五、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本署留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供：

- 一、本人已充分獲知且已瞭解上述經濟部產業發展署告知事項。
- 二、本人同意經濟部產業發展署於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：

中 華 民 國 年 月 日